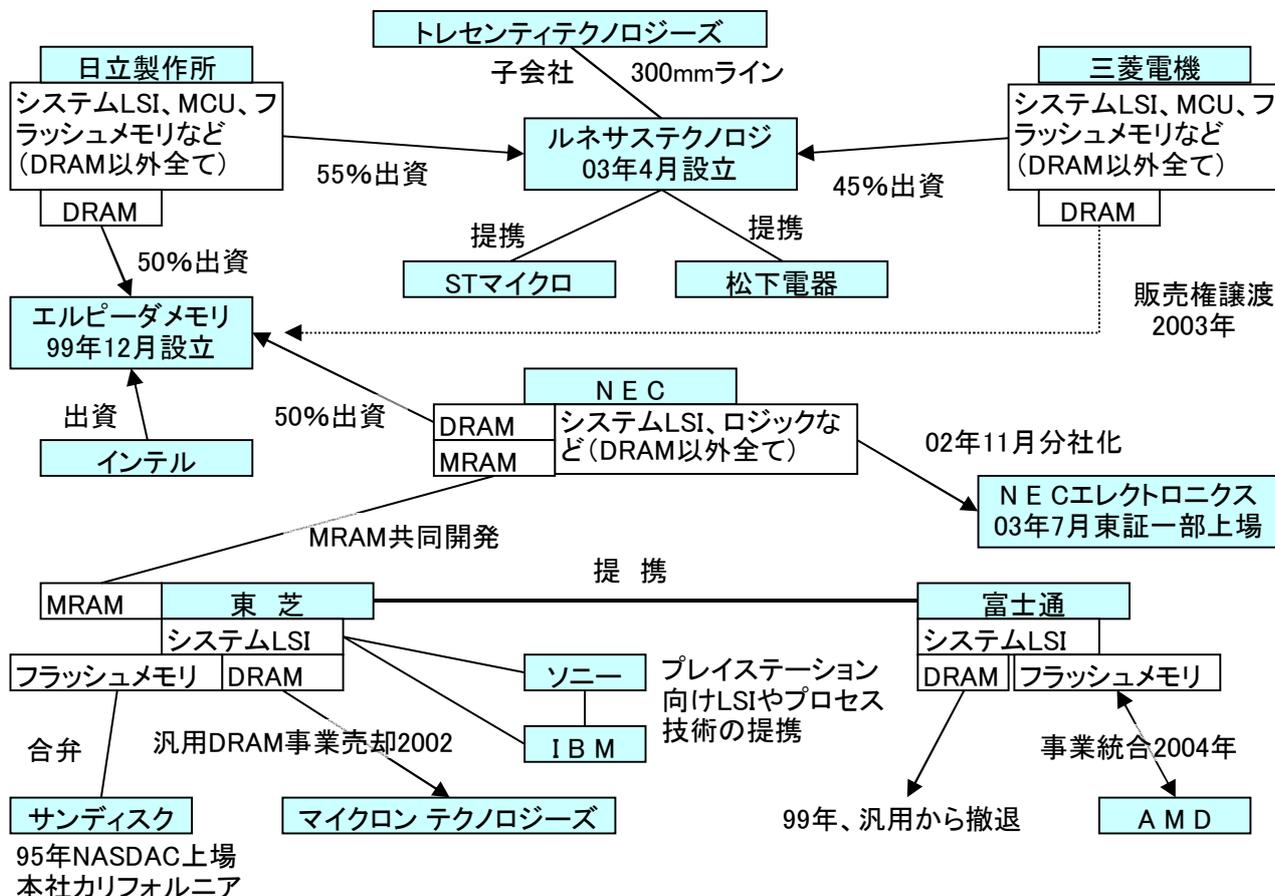


日本の半導体業界の再編動向

出所:『JOYO ARC』2004年2月



DRAM: dynamic random access memory 記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ
 MRAM: magnetoresistive random access memory 磁気抵抗メモリ。不揮発性でDRAMより高速。
 MCU: microcontroller unit 超小型制御装置。電子機器用マイクロプロセサー。

◇その後の推移◇

- 2004年 富士通とAMDがフラッシュメモリ事業を統合し、Spansion社を設立。
- 2005年 ルネサスがトレセンティを吸収合併。
- 2008年 富士通が半導体部門を分社化、富士通マイクロエレクトロニクス(株)を設立。
- 2009年 富士通がファブライト型事業モデルを発表。
- 2010年4月 富士通マイクロエレクトロニクスを富士通セミコンダクター(株)に改称。
- 2010年4月 NECエレクトロニクスとルネサステクノロジが統合、ルネサスエレクトロニクス(株)を設立。
- 2012年2月 エルピーダメモリが会社更生手続きの開始を申し立て。7月 マイクロン社がエルピーダの買収契約に調印。
- 2012年4月 富士通セミコンが岩手工場(半導体前工程)をデンソーに売却。
- 2012年7月 ルネサスが10工場の売却・閉鎖や早期退職500人を発表。システムLSI事業を分離しマイコン専業をめざす。
- 2012年8月 富士通がLSI後工程の3工場(宮城、会津、鹿児島)を(株)ジェイ・デバイスに譲渡・移設。